

[release_LGA1700-BCF]

【Thermalright 社 CPU・クーラー間の接触を改善し、「反り」問題を改善する

intel LGA1700 CPU 向けフレーム「LGA1700-BCF」を販売開始



intel 12th CPU Bending Corrector Frame

LGA1700-BCF



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は Thermalright 社(本社：台湾)製 CPU・クーラー間の接触を改善し、「反り」問題を改善する intel LGA1700 CPU 向けフレーム「LGA1700-BCF」を 2022 年 7 月 14 日(木)より発売いたします。

本製品は、マザーボードの CPU ソケット ILM と入れ替えて使用するフレームで、intel の第 12 世代 CPU で発生する「反り」問題を解決するマウントフレームになります。ハイエンド CPU クーラーなどを使用し、キッチリ固定したいユーザー様向けのアイテムと言えるでしょう。

標準ソケット ILM の取り外しは改造行為となりますので、マザーボードの保証が無くなることにご注意ください。また、交換したことにより、万が一 CPU やマザーボードが壊れたとしても保証はできませんので、ご了承ください。

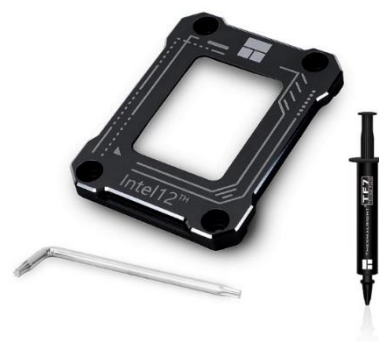
■ 製品名/製品型番	LGA1700-BCF BLACK (型番：TR-1700-BCF BLACK)	JAN コード：0814256004589
■ 製品名/製品型番	LGA1700-BCF GRAY (型番：TR-1700-BCF GRAY)	JAN コード：0814256004596
■ 製品名/製品型番	LGA1700-BCF BLUE (型番：TR-1700-BCF BLUE)	JAN コード：0814256005227
■ 希望小売価格	1,980 円 (税別)	

■ 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/lga1700-bcf/>

■ メーカーURL <http://www.thermalright.com/product/lga1700-bcf-black/>
<http://www.thermalright.com/product/lga1700-bcf-gray/>
<http://www.thermalright.com/product/lga1700-bcf-blue/>

■ 製品特徴

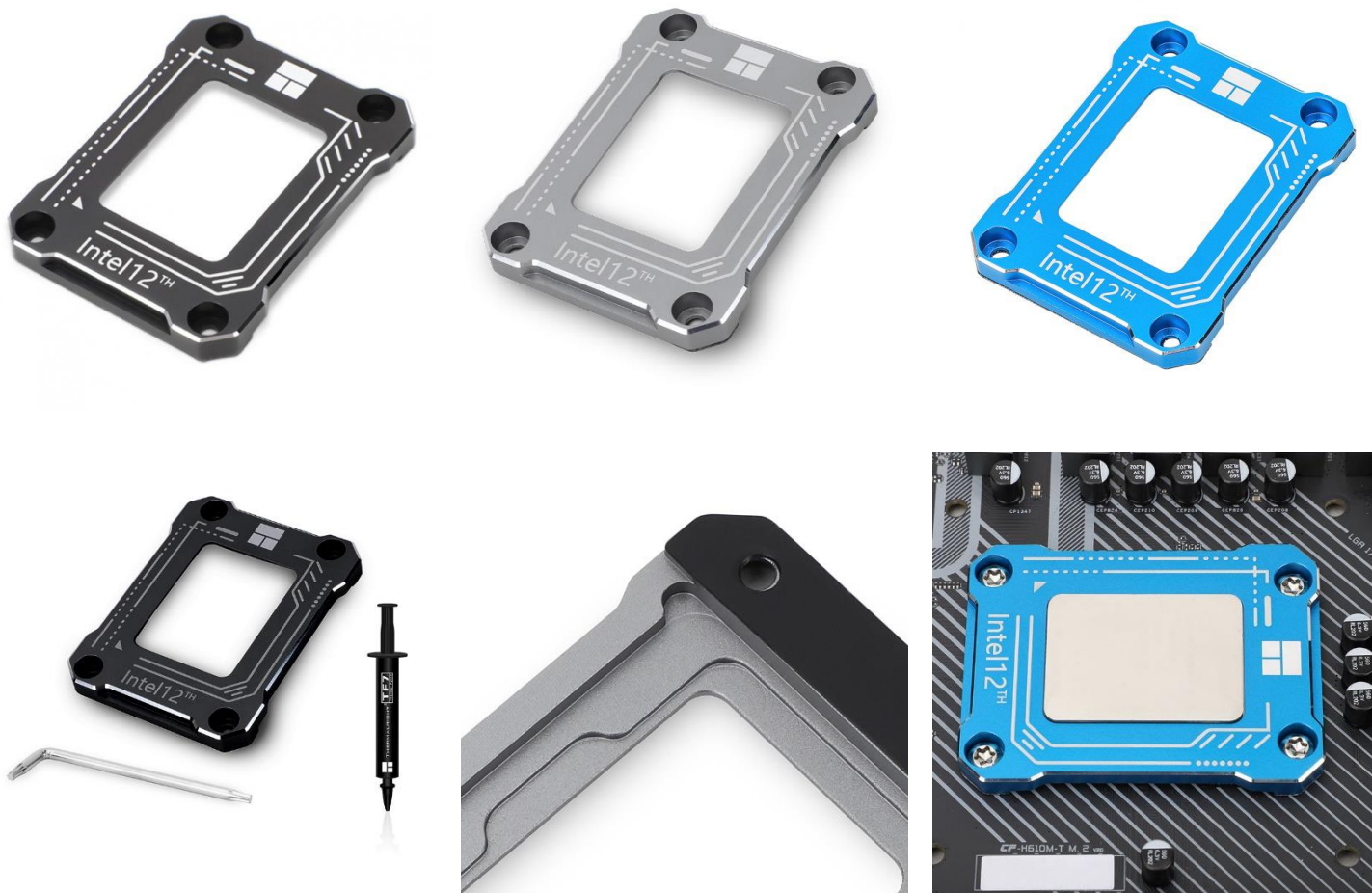
- ・アルミ削りだしのフレーム
- ・L型のドライバーと TF7 2g が付属
- ・ブラック/グレイ/ブルーの3色をラインナップ



■製品仕様

製品名/製品型番	LGA1700-BCF BLACK	LGA1700-BCF GRAY	LGA1700-BCF BLUE
JAN コード	0814256004589	0814256004596	0814256005227
カラー	ブラック	グレイ	ブルー
対応ソケット	Intel LGA1700 ILM ソケット		
材質	アルミ削りだし		
製品サイズ/重量	50 x 70 x 6 (mm) / 20g		
製品保証	1年		
備考	<p>※1 標準ソケット ILM の取り外しは改造行為となりますので、マザーボードの保証が無くなることにご注意ください。</p> <p>※2 交換したことにより、万が一 CPU やマザーボードが壊れたとしても保証はいたしかねますので、ご了承ください。</p> <p>製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。</p>		

■製品画像



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880

e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください。